本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！

KPMG 毕马威 | GSA

半导体行业超级周期已经开启？

《2026年毕马威全球半导体行业展望》主要探讨人工智能驱动的需求、供应链限制以及宏观经济不确定性背后的影响因素

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!

目录

01 前言

02 摘要——超级周期重塑半导体行业

03 简介——冰火两重天

04 区分人工智能神话与现实

05 主要发现

06 主要建议

07 毕马威和全球半导体联盟可提供的专业服务

08 附录

欢迎您阅读毕马威第21期年度——《全球半导体行业展望》，本报告分析了对全球半导体企业的151名高管层所开展的调查，并分享了我们的主要发现。过半数受访者来自年收入超过10亿美元的企业。本调查由毕马威与全球半导体联盟（GSA）于2025年第4季度联合开展。

本刊物专为半导体企业的首席执行官、首席运营官、首席财务官、财务总监、财务负责人、战略和企业发展人员而设。本刊物同样适用于产品高度依赖半导体组件的企业的高管，包括电信、电信基础设施、云服务、数据中心、人工智能（AI）、平台提供商、支持物联网（IoT）应用的设备和汽车电子应用等领域的产品。

© 2026 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！

前言

二十多年来，毕马威通过年度全球半导体行业展望调查，长期追踪并观察这个受创新、投资周期和全球竞争影响的行业的发展动态。2026年，半导体行业迎来了最重要的历史时刻：人工智能如今不仅成为了整个半导体供应链需求增长的首要引擎，也不断促使半导体企业调整产品路线图，加速资本投资，彻底改变战略，推动内部工作转型。

这些变化在各个市场上引发了一系列连锁效应，其速度之快令许多人始料未及。在过去几年里，半导体行业的领导者们一直在思考人工智能的爆炸式增长是否正带动该行业进入“超级周期”。如今，他们又面临一系列新的问题：如何跟上人工智能发展的速度并构建自身能力？如何在不减缓创新的情况下分散风险？全球政治、贸易和制造业回流会产生什么影响？如何帮助员工在人工智能驱动的未来茁壮成长？

毕马威第21期《全球半导体行业展望》借鉴了来自世界各地和毕马威内部的行业高管的观点。我们的调研结果清楚表明：当前的增长具有广泛基础，源于实际需求，而并非炒作。高管们也意识到，能否持续保持竞争优势将取决于是否具备良好的灵活性、韧性，以及是否能够通过人工智能应用战略赋能人才并提升运营效率。

本文评估了未来十年半导体企业赢得行业领导地位的机遇和制约因素。我们还提供许多切实建议，这些建议以数据为基础，也凝聚了我们与业内领先企业的合作经验，可助您有效掌控当前局面。

希望今年的报告能使您在制定未来规划时具备清晰视野、愿景目标和切实可行的真知灼见。我们相信，超级周期已经到来。企业领导者现在做出的选择不仅将决定企业自身的发展轨迹，也将左右未来全球技术发展格局。



Christian Gentle
毕马威全球半导体业务
主管合伙人
毕马威美国



Chad Seiler
科技、媒体及电信业务
主管合伙人
毕马威美国



Cecil Mak
美国科技行业主
管合伙人
毕马威美国

© 2026 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！

摘要

超级周期重塑半导体行业

在整个半导体行业中，各企业董事会关注的焦点已经发生了转变。过往数年，他们一直在探寻行业周期更替的时间。如今，他们已经转而关注企业能以多快的速度强化自身，跟上变化的步伐。对人工智能的真实需求表明，半导体行业的超级周期或许已经开启。

毕马威第21期《全球半导体行业展望》基于对全球半导体企业的151名高管的调查。此次调查表明，人工智能驱动的需求并非泡沫，它标志着市场的根本性转变。在以人工智能为核心的驱动力作用下，云计算、内存以及核心处理等领域出现了广泛增长。为此，企业领导者必须在管理供应、人才和资本的同时，把握住巨大的机遇。

人工智能首次成为主要的收入引擎。在我们的调查中，73%的企业领导者将人工智能视为其收入增长的主要因素，这一比例高于去年的67%，并领先于云计算和数据中心。人工智能计算需求暴涨使内存需求激增：如今，67%的受访者认为内存最具增长潜力，与微处理器的66%基本持平，这是该调查历史上首次出现这种情况。综合来看，这些变化表明，人工智能正推动市场整体发展，用于计算、存储和移动数据的芯片均同步增长。

半导体行业领导者已将供应链灵活性视为应对地缘政治压力和贸易不确定性的首要战略重点。45%的受访者表示，对供应链响应速度与灵活性提升的重视程度，三年来首次超过了人才培养。其发展重点清晰明确，即内建和外购并举，实施数字化规划，并缩短供应链整体响应周期。

企业领导者正着手向内部引入人工智能，以应对人才缺口问题。66%的企业计划使用人工智能来提高员工生产力，包括提升团队技能，自动化执行常规任务，并释放稀缺的工程和运营人才，使其专注于高价值的工作。这些有助促进增长的措施不仅仅出现在企业层面，行业整体亦是如此。

风险虽已显现，信心仍不断上升。今年，半导体行业信心指数从去年的59上升到63，是我们开展调查21年以来的第三高的水平。许多企业正着手制定增长规划，他们中大多数预计将增加资本支出、员工人数和IT投资。这种乐观情绪源于强劲的跨季度需求信号，虽然企业领导者对地缘政治、贸易摩擦和资源限制依旧保持警惕。



半导体行业领导者已将供应链灵活性视为首要战略重点，以应对地缘政治压力和贸易不确定性



45%的受访者表示，对增强供应链响应速度和灵活性的重视程度三年来首次超过了人才培养。其重点十分明确，即内建和外购并举，实施数字化规划，并缩短响应时间。

尽管此次调查显示，人工智能正开启半导体超级周期，但众多技术领导者仍表达了对需求及其持续性的担忧，这些担忧与供应链限制、能源供应和地缘政治不稳定有关。为了保持韧性，半导体企业应建立能灵活应对需求变化的商业模式，通过供应链多元化降低地缘政治风险，并投入研发以引领下一轮架构和应用变革的浪潮。企业还应着眼未来，利用人工智能为员工赋能，使其能够围绕人工智能开展工作。总而言之，只有措施得当，企业领导者才可为未来十年企业业绩强劲发展奠定基础。

© 2026 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！

简介：冰火两重天

全球经济面临着冰火两重天的局面。一方面，人工智能正创造出一场前所未有的繁荣，从芯片制造商到科技巨头的整个生态系统吸引了数千亿美元的投资。另一方面，人工智能之外的经济领域形势却颇为黯淡。传统制造业和房地产等行业正经历裁员[1]，全球贸易受到关税和不确定性的阻碍[2]，公共预算逐渐收紧[3]。这种巨大差异引发了一个关键问题：

人工智能驱动的支出增长还能持续多久？

半导体行业正处于不确定性的风口浪尖。一方面，人工智能已经显著超越云计算和数据中心，成为半导体行业的最大收入驱动因素。芯片、高带宽内存（HBM）和其他人工智能所需设备均是促成此类发展的关键，它们为人工智能应用中的复杂计算和数据分析提供了更快、更高效的处理能力，以及更高的数据存储密度。

另一方面，杠杆投资[4]、宏观经济波动和全球事件也导致人们担忧当前人工智能驱动的需求存在泡沫，终将因不堪其重而崩塌。对于企业高管而言，加倍押注这种增长潜力可能获得颠覆性收益，也可能导致灾难性失误。

我们对此作了深入的调查研究，调查结果表明当前市场对人工智能存在真实的需求，而非炒作，这符合我们的客户服务感知。调查还表明，领导者若能为企业打造灵活的应变能力、实现供应多元化，并使用人工智能赋能员工和运营，将有助企业在未来十年获得显著的竞争优势。

在这个响应速度和灵活性成为胜负关键的时代，半导体企业高管面临的难点在于如何建立韧性并抓住机会。因此，下文旨在帮助半导体企业领导者了解当前趋势以及应对之策。

[1]《A miserable year for workers》，毕马威，2026年1月9日
[2]《Global Trade Update (January 2026): Top trends redefining global trade in 2026》，联合国贸易和发展会议
[3]《States Finalize Fiscal 2026 Budgets Amid Tightening Conditions》，美国国家州政府预算官员协会，2025年7月1日
[4]《Capital Flows into Leveraged Semiconductor Bets: A Macro View of the 2026 Sector Rebalance》，AInvest，2026年1月14日

© 2026 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。



本报告来源于“慧博投研” 请勿外传!

区分人工智能神话与现实

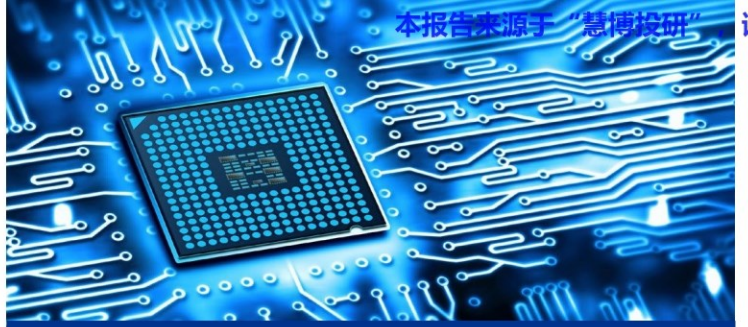
部分投资者仍然担心当前人工智能浪潮纯属资本炒作，但证据表明事实并非如此：人工智能的快速发展显然是由需求驱动，其增长具有可持续性，已经获得实际应用以及前所未有的投资承诺。

> 数据中心已满负荷运作。2025年第二季度，数据中心使用率达到92.4%，创下历史新高。这表明这些设施内部的计算资源（包括用于人工智能的GPU）正在被充分利用，而非处于闲置状态。[5]

> 投资范围广泛，覆盖全球各地。仅在2025年，该行业就达成了100多笔数据中心交易，其中610亿美元用于投资建设计算基础设施，以满足日益增长的人工智能应用需求。这一数字与2024年608亿美元的交易量大致相当。自2019年以来，美国和加拿大、亚太地区以及欧洲的数据中心累计投资（包括并购、资产出售和股权投资）已分别达到1,600亿美元、400亿美元和242亿美元。[6] 这种规模和分布表明这是一场结构性转变，而非短期大量投机。北美和亚太地区的投资强度持续高于欧洲，这可能是由于欧洲受较高的能源成本、共建半导体供应链以及更严格的数据主权法规所累。

> 人工智能也在终端设备领域扩展。对于既负责生成数据又负责处理数据的设备（如手机、汽车和工厂设备），其制造商正逐步将专用人工智能核心融入其中。随着这一趋势的加速，以及人工智能通过云服务的快速部署，预计到2029年，与人工智能处理相关的半导体的收入将达4,385亿美元，五年复合年增长率（CAGR）达25.9%。[7]

> 芯片制造商着力开展投资，以寻求长期发展。2025年，晶圆制造设备（WFE）支出增长了12%，从前一年1,040亿美元上升到1,160亿美元。这表明对先进制程逻辑芯片和存储芯片生产能力的投资力度加大。行业预测认为，2026年晶圆制造设备支出将再增长9%，达到1,260亿美元，这表明此轮投资周期将持续多年，而非短期上行。[8]



区域差异

人工智能在驱动半导体行业收入增长的重要性因地区而异。在调查中，美国受访者最重视人工智能（81%），这反映美国具有强大的技术生态系统，较为聚焦半导体和人工智能驱动创新。紧随其后的是欧洲（70%）和亚太地区（67%），这些地区的受访者对人工智能作为收入驱动因素的重视程度相对较低。

若人工智能的应用和计算强度继续以当前速度发展，半导体企业领导者应考虑如何调整投资重点、供应链韧性和全球产能分配。他们做出的选择将决定未来十年的竞争优势。

[5]《Is There Enough Data Center Capacity for AI?》，高盛，2025年12月11日
[6] 同上
[7]《Forecast: AI Processing Semiconductors, Worldwide, 2023-2029, 3Q25 Update》，Gartner，2025年10月8日
[8]《Global Semiconductor Equipment Sales Projected to Reach a Record of $156 Billion in 2027》，SEMI，2025年12月16日

© 2026 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!

主要发现

1



人工智能成为收入增长的主要驱动因素

表示人工智能已成为半导体企业收入增长的主要驱动因素的受访者从去年的67%增加到73%。云计算、数据中心和网络紧随其后，占比为61%，低于此前的63%。

2



内存与微处理器相并列成为最大的增长机会点

67%的高管表示，内存解决方案目前是增长重点，高于去年的49%，缩小了与微处理器的长期差距。

3



供应链成为首要议题

供应链三年来首次成为最受重视的领域。此外，45%的受访者认为，提高供应链的响应能力是他们的首要任务。

4



人工智能旨在赋能而非取代员工

41%的受访者认为，未来三年，人才是行业面临的第二大挑战。三分之二的半导体企业高管将人工智能视为人才赋能手段，而非取代人类员工的工具。

5



乐观者不惧风险全速前进

我们今年的调查发现，信心指数已经从去年的59上升到63，这是21年来的第三高水平，表明尽管面临持续挑战，但受访者仍保持乐观。

© 2026 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!

主要发现1

人工智能成为收入增长的主要驱动因素

人工智能的每项应用（无论是在工厂生产线上标记缺陷，起草销售提案，还是自动驾驶汽车），都始于一个简单的问题：系统能否足够快地基于海量数据制定有效决策？半导体为达到这种速度提供了保证。它们就像每个模型背后的肌肉和记忆，可以敏捷地移动数据，并以惊人的速度处理数据。若未能将适当的芯片部署在适当的位置，人工智能就无法大规模实施。这就是为什么越来越多产品路线图、预算和上市计划的制定都从芯片的选择开始。

与以往科技浪潮不同，人工智能正迅速、广泛地推动半导体行业增长。半导体行业对人工智能的重视程度正逐渐超越云计算，这种差距不断拉大。在我们的调查中，73%的受访者认为人工智能是他们最大的收入增长驱动因素，高于去年的67%。相比之下，将云计算/数据中心/网络视为最大收入驱动因素的受访者则从去年的63%下降到61%。到2029年底，全球人工智能半导体市场规模预计将达到4,385亿美元，五年复合年增长率达25.9%。[9] 这种激增反映了人工智能在设备、车辆、数据中心和工业系统方面的广泛应用，它不仅仅涉及单一市场，而是会引起全面转型。

73%

的受访者当前认为人工智能是他们的最大收入驱动因素

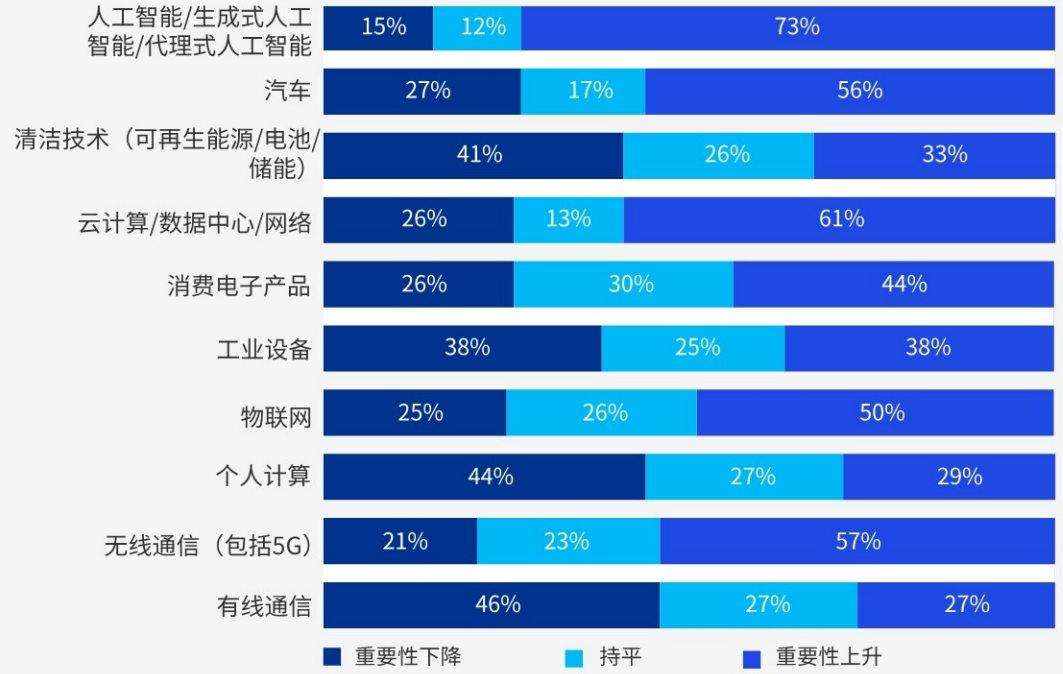
要点

人工智能并非叠加在现有产品之上的新功能。相反，它是能够决定收入增长的主要力量。随着人工智能推动行业整体需求增长，下一个战略问题是供应链能否迅速响应。

[9]《Forecast: AI Processing Semiconductors, Worldwide, 2023–2029, 3Q25 Update》，Gartner，2025年10月8日

附录1：收入驱动因素

与本年度相比，贵公司如何看待下一财年半导体相关的各项资本支出（包括设备和软件）？



注：由于四舍五入，上图百分比合计可能不等于100%。
资料来源：毕马威与全球半导体联盟联合开展的全球半导体行业调查，2025年第4季度

© 2026 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!

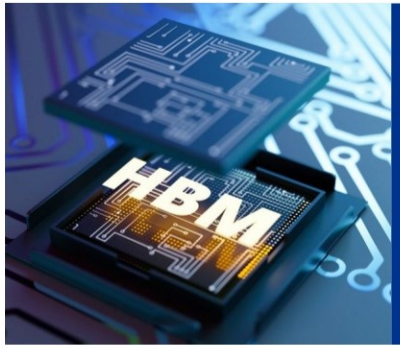
主要发现2

内存与微处理器相并列成为最大的增长机会点

从我们开展半导体行业调查以来，内存解决方案首次出现，并被67%的高管提及，跃居增长列表之首，比去年的49%大幅跃升，缩小了与微处理器之间多年存在的差距。

对内存（尤其是高带宽内存）日益增长的需求，与人工智能计算需求的增长直接相关。人工智能应用需要更快、更高效的处理能力，这又推动了对高容量存储和先进内存解决方案的需求。因此，随着人工智能应用的增加，对高容量和高带宽内存解决方案的需求也水涨船高。

与此同时，包括亚马逊、谷歌云和微软Azure在内的科技巨头正加快对人工智能所需的高带宽内存的投资，逐步远离传统动态随机内存（DRAM）。事实上，一些动态随机内存制造商正在重新调整生产线，生产高带宽内存芯片，以从需求提速中获利。因此，动态随机内存正变得越来越稀缺。这种变化标志着整个半导体行业价值链的竞争格局正在发生全面重塑。

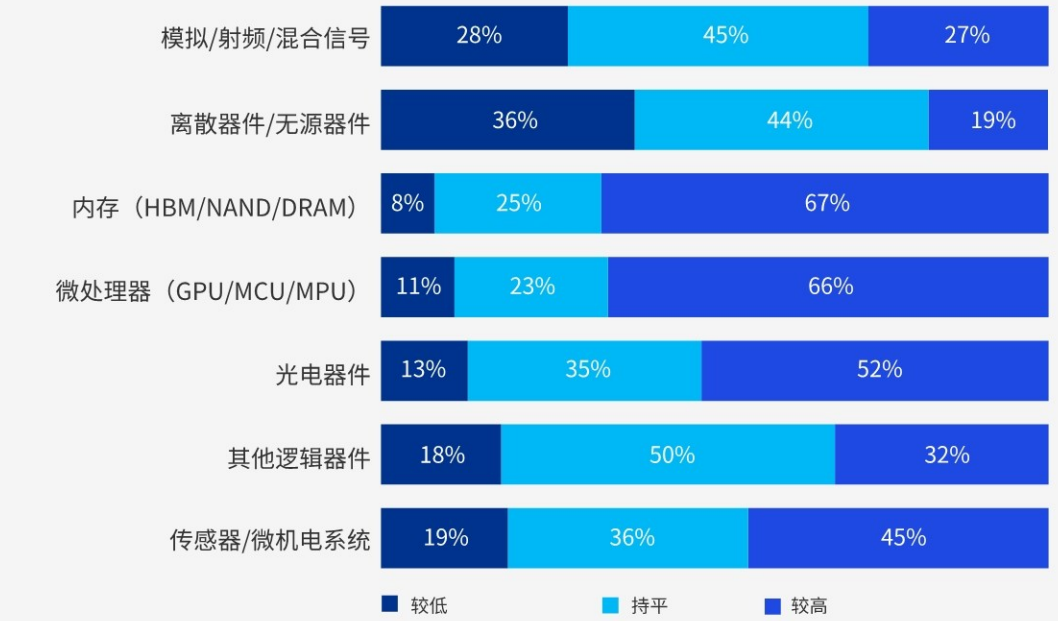


要点

人工智能并非叠加在现有产品之上的新功能，而是能够创造收入增长的主要力量。随着人工智能推动行业整体需求增长，供应链能否迅速响应成为了下一个战略问题。

附录2：增长机遇

请评估半导体行业以下各项未来12个月的增长机遇。（每行选择一项）



注：由于四舍五入，上图百分比合计可能不等于100%。
资料来源：毕马威与全球半导体联盟联合开展的全球半导体行业调查，2025年第4季度

© 2026 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。

本报告来源于"慧博投研" 请勿外传!

主要发现3

供应链成为首要议题

调查显示，供应链三年来首次成为重中之重。这一转变反映了受访者面临的现实问题，包括新冠疫情揭示的风险，国际关系紧张，以及稀土等关键材料获取困难等。

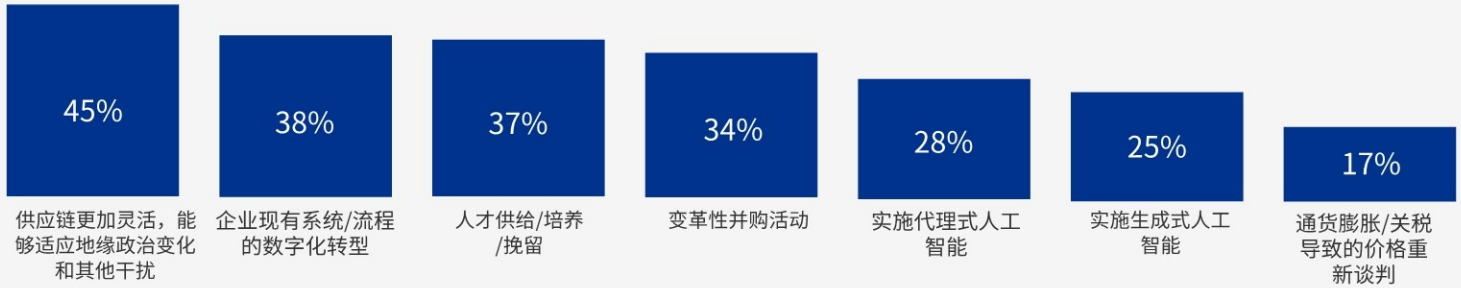
供应链已成为战略重点 #1

增强供应链响应速度和灵活性是新的当务之急

与去年人才培养最受重视不同，在今年的调查中，45%的受访者将增强供应链响应速度列为首要任务。而地缘政治不确定性和其他颠覆风险也依然备受关注，37%的受访者认为，这是半导体行业未来三年面临的第三大问题（共11个问题）。

附录3：战略重点

除收入增长外，贵公司未来三年的前三大战略重点是什么？
（最多选择三项）



资料来源：毕马威与全球半导体联盟联合开展的全球半导体行业调查，2025年第4季度



能源是否成为瓶颈?

人工智能驱动的需求激增，给供给侧带来了一个重大问题：行业及业内科技巨头能否获得足够的能源来维持这种增长?

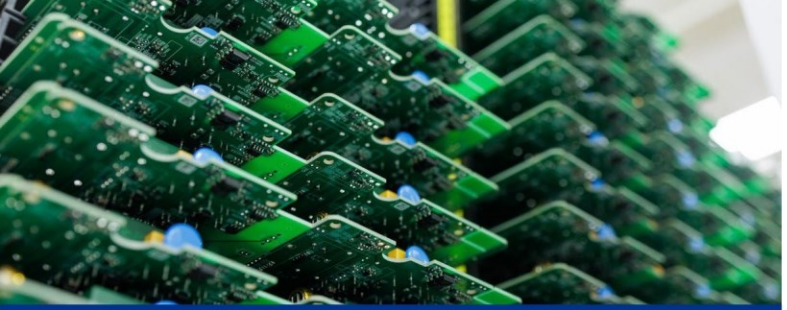
考虑产能建设：34%的受访者担心未来三年内可能无法为其自身的生产设备提供足够的电力。数据中心则面临更大挑战：58%的受访者担心科技巨头可能难以获得足够的能源来扩建人工智能所需的基础设施。

内存与微处理器成为首要增长点，标志着一个新时代的开启。在这个时代中，企业对技术架构的选择将影响其市场地位，而能源限制也可能会像供应链冲击一样带来严重后果。解决的方案就在于推动需求的技术本身——人工智能用于优化数据中心的能源效率，在不增加电力能耗的情况下提升数据中心的容量。

[9]《Forecast: AI Processing Semiconductors, Worldwide, 2023–2029, 3Q25 Update》，Gartner，2025年10月8日

© 2026 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!



公私合作：喜忧参半

调查还发现，企业领导者面临着一个两难的境地：既要与政府开展合作，又要确保自身的敏捷性。为了在技术前沿展开竞争，企业引入公共资金和与政府联合投资似乎不可避免。然而，政府的参与往往附带市场行为的条件，这可能会限制采购和市场准入的灵活性。

48%的受访者担心政府补贴对半导体行业的影响，大多数受访者（54%）同意接受政府股东将限制企业的市场灵活性和创新能力。然而，受访者似乎也意识到，私营行业有时不可避免的需要政府帮助推动变革：同样比例（54%）的受访者认为，现在需要政府提供投资或持有股权的方式来建设全球最先进的芯片制造厂。

数字背后隐藏着一个简单的事实。半导体行业依赖一个由专业供应商和制造中心（尤其是在中国台湾等地）组成的复杂全球网络，而政府在对芯片制造的方式和地点的选择方面会进行更多干预。这种复杂情况在带来机遇的同时，也增加了风险。

韧性培养计划

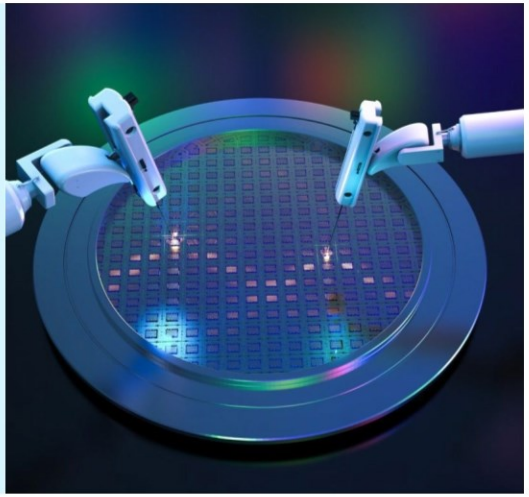
受访者表示，他们计划通过将生产和采购分散到更多区域来增强韧性。此举目标非常简单，是为了确保在一个地区出现问题时，仍能顺利获得产品供应。为此，过半数受访者（54%）计划在未来12个月内扩大供应链的区域分布。

受访者也正转用生成式人工智能，以更具前瞻性、更快速地制定决策。36%的受访者表示，未来12个月内他们将率先在采购和供应链管理职能中使用生成式人工智能，届时将使用预测分析和自动化等工具来预测短缺，调整平衡库存，并提早确保产能。

各地区的战略存在差异：美国和欧洲企业将重点放在国内制造和回流上（《芯片法案》、《欧洲芯片法案》），而亚洲企业则希望在地区网络中引入备用方案。

要点

当前，半导体行业正从单一供应链向构建供应安全网转变，但在这一轮半导体周期（或超级周期）中，在实现宏伟技术目标与完全控制供应链之间保持平衡将是管理层面临的决定性挑战之一。赢得先机的企业，将化波动为优势，既可确保当前交付，又可为未来增长做好准备。在重塑供应链以提高韧性的同时，半导体企业领导者还需确保员工能够跟上人工智能驱动的转型步伐。



© 2026 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!

主要发现4

人工智能旨在赋能而非取代员工

面对人才持续短缺，半导体企业的领导者正加紧招聘，并加大力度利用人工智能提高生产力。随着人类和智能系统以新方式开展协作，业界对竞争优势的定义也悄然发生转变。半导体已不仅仅只为通用计算提供支持。只有先于竞争对手彻底改革其产品、运营和市场战略，为人工智能驱动的世界提供服务的企业才能在未来十年脱颖而出。

在这些领先企业的内部，人工智能已经在重塑工作方式。首当其冲的是IT和研发领域：自动化可以加速决策，改进流程并消除日常工作流程中的冲突。其次是采购和供应链领域，企业领导者认为人工智能可有助预测需求、简化物流和降低风险。与此同时，营销和销售领域也正利用人工智能进行个性化推广和预测客户需求。更先进的、代理式人工智能工具也正在这些领域迅速扎根。

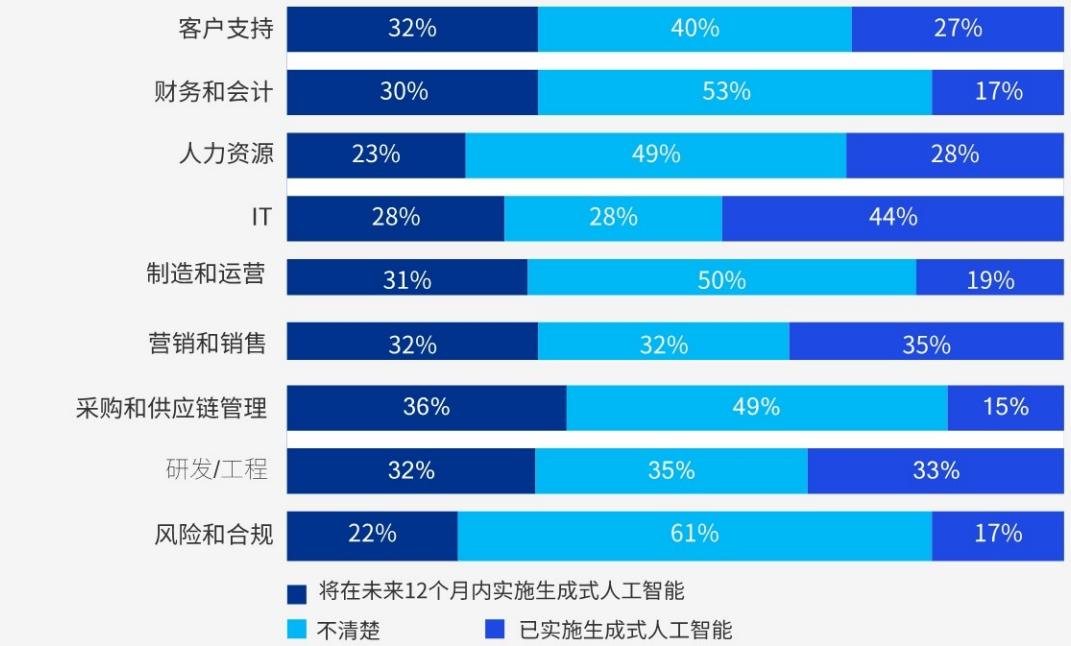
36%

采购和供应链管理是近期实施生成式人工智能的主要领域

在半导体企业内部，人工智能作用巨大且不断发展，影响的领域包括IT（44%）、研发、供应链管理和营销。半导体企业已经在IT（44%）和研发领域实施了生成式人工智能，人工智能驱动的自动化可以加快决策、改进流程并简化工作流程。采购和供应链管理是近期实施生成式人工智能的主要领域（36%），人工智能可增强需求的预测性分析，优化物流，减缓供应链风险。人工智能还被部署来增强客户参与度、制定个性化营销策略并改善销售的预测（各30%）。

附录4：人工智能

贵公司已经或预计未来12个月内在以下哪些职能实施生成式人工智能？（每行选择一项）



注：由于四舍五入，上图百分比合计可能不等于100%。
资料来源：毕马威与全球半导体联盟联合开展的全球半导体行业调查，2025年第4季度

© 2026 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。

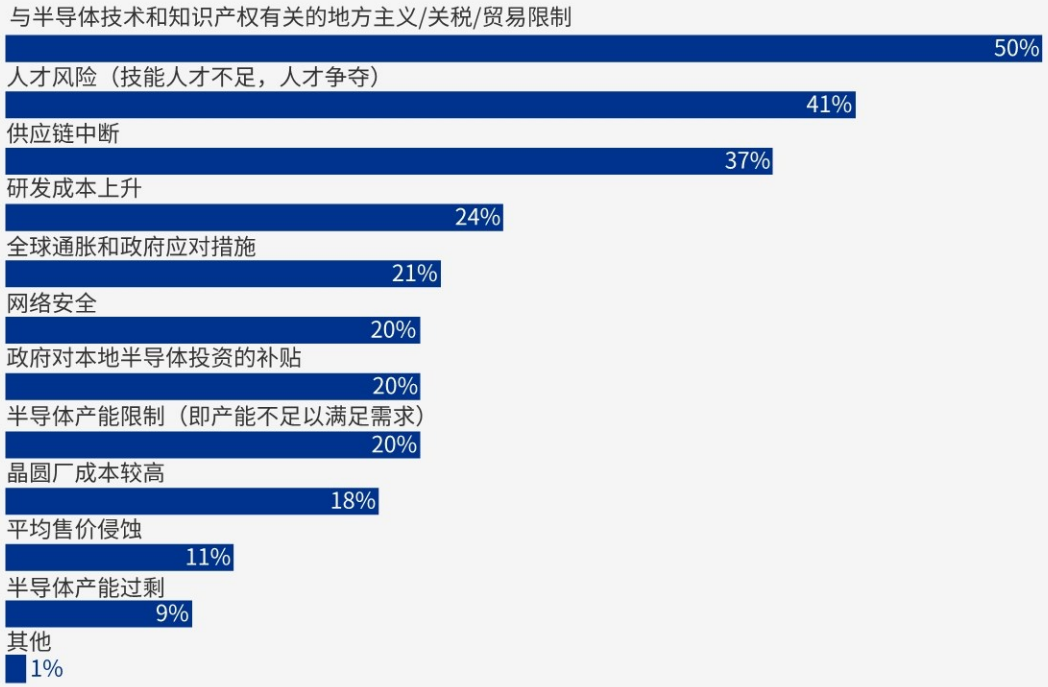
本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!

人才的引育与留存，已成为企业核心战略任务

人工智能并未消除企业对人类员工的需求。受访者指出，人才已成为仅次于关税的重大挑战，培养和留住人才是企业的首要战略任务之一。

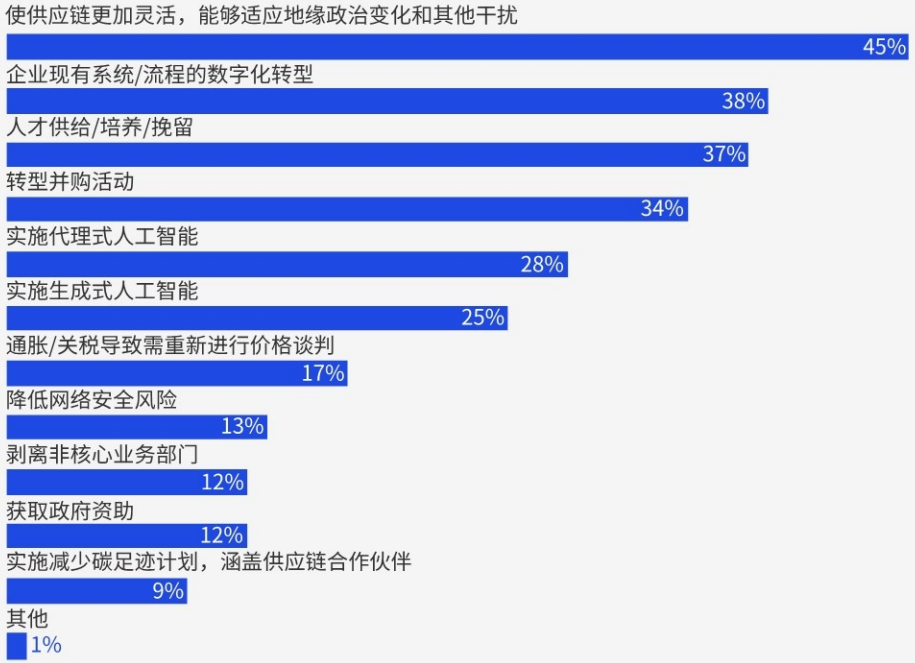
附录5：行业问题

您认为未来三年全球半导体行业面临的最大问题是什么？（最多选择三项）



附录6：战略要务

除增长外，贵公司未来三年的前三大战略重点是什么？（最多选择三项）



资料来源：毕马威与全球半导体联盟联合开展的全球半导体行业调查，2025年第4季度

© 2026 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。

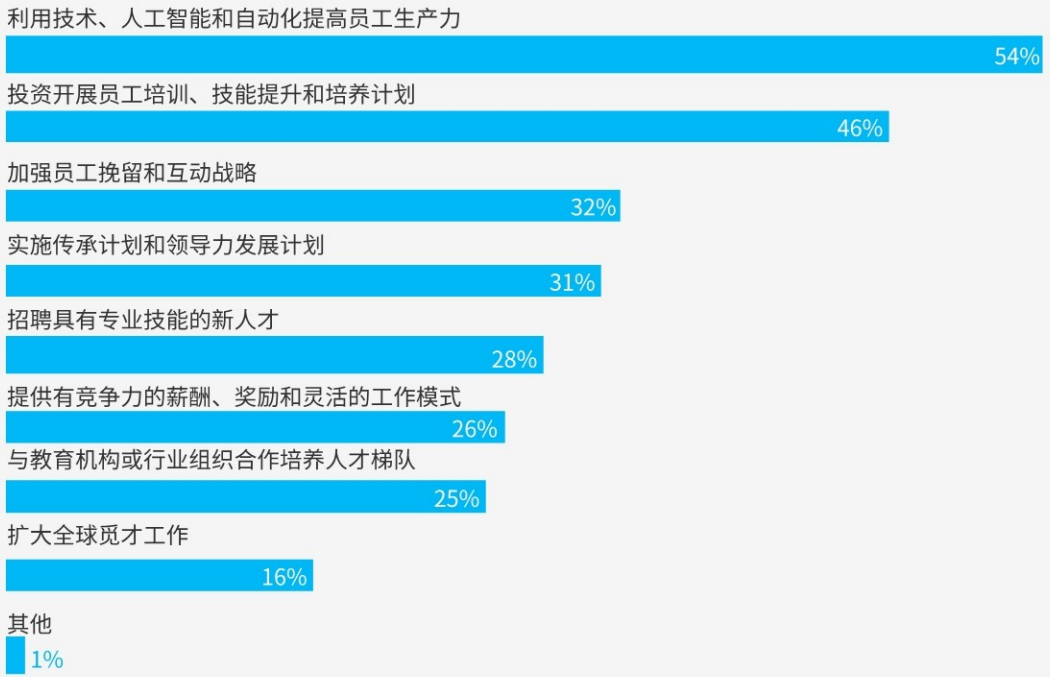
本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!

为了满足不断增长的人力需求，65%的受访者预计未来一年将增加员工数量。但他们也清楚人工智能将扮演的角色。为实现增长目标，企业首先采取的措施为利用技术、人工智能和自动化来提高员工生产力（54%），其次是员工培训和技能提升计划（46%）。

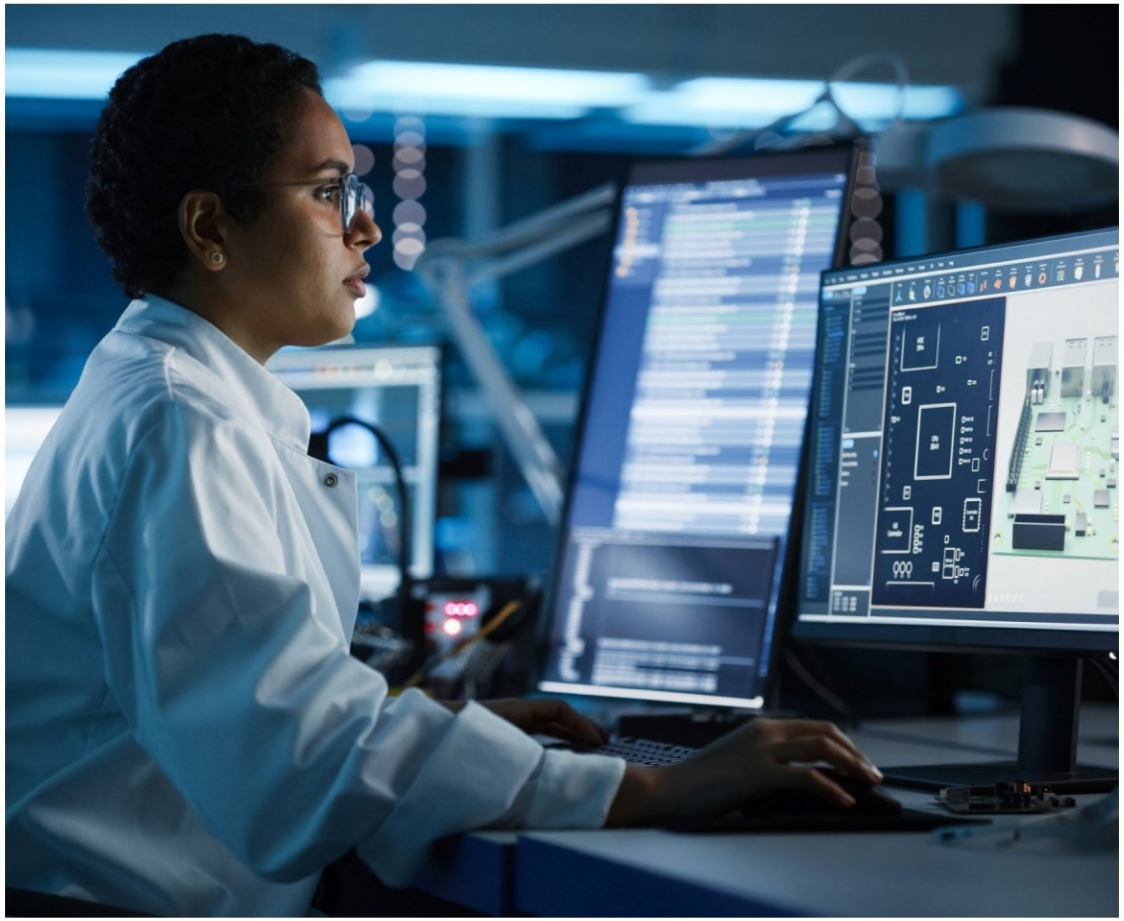
随着员工队伍得到扩展并与人工智能通过创新方式协同工作，具有自适应能力的人工智能系统可将人类员工的专业知识应用于更广泛的领域。这种变化将影响半导体价值链企业雇佣、培养和设计人才队伍的方式。随着市场趋势的日益显现，各企业正迅速做出调整。

附录7：行业所面临的难题及战略重点

贵公司正通过什么措施确保拥有实现增长目标所需的人才？（最多选择三项）



资料来源：毕马威与全球半导体联盟联合开展的全球半导体行业调查，2025年第4季度



© 2026 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!

主要发现5

乐观者不惧风险全速前进

当被问及对未来一年的看法，半导体企业的领导者纷纷表明，尽管存在地缘政治和资源风险，但他们的信心正逐步增强。我们的调查显示，业界的信心指数从去年的59上升到63，是该调查开展21年以来的第三高。这表明，尽管挑战依然存在，但受访者仍较为乐观。

从市场层面来看，对增长的预测与这种乐观情绪形成呼应。预计到2026年，全球半导体市场规模将攀升至1万亿美元。[10] 逻辑芯片和存储芯片领域的增长最为强劲，主要受人工智能和数据中心需求的推动。自2022年末以来，全球半导体销售额已增长了约50%，进一步证明了这一轮增长是长期持久的，而非短暂反弹。[11]

有鉴于此，各企业领导者正顺势而为。过半数受访者（54%）预计他们的企业收入将增长11%或以上。未来12个月其首要举措为雇佣更多员工，升级IT系统并推进并购，显然对增长前景颇为看好。投资计划也反应了同样的趋势，66%的受访者预计未来一年的资本支出将增加，高于去年的63%。

然而，企业并非盲目乐观。尽管企业的发展步伐在加快，但仍有58%的受访者预计，未来12个月内客户需求的不确定性将产生重大影响。在供应方面，企业领导者主要关注与稀土、化工和能源相关的地缘政治和其他压力，也对全球事件可能造成的颠覆持谨慎态度。

那么，企业应如何在谨慎看待需求的同时，实施积极的增长计划？时机把握是其中的关键因素，因为许多芯片制造商目前积压了大量订单，生产速度无法满足利润率较高的中期需求，而需求随着季度更迭起伏不定，产品组合也可能会迅速发生变化。由于业界普遍预计市场规模将在下一个发展周期实现翻倍，因此企业高管可能也正相应审视其投资组合的前景。

附录8：全球半导体市场与行业信心

（单位：十亿美元）



资料来源：世界半导体贸易统计协会、毕马威与全球半导体联盟联合开展的全球半导体行业调查，2025年第4季度

总而言之：这是一个充满信心的市场，正处于一个具有重大意义的投资窗口期。企业将通过扩大产能、强化人才储备和提升核心能力来实现向上增长，同时通过更敏锐的需求感知、多元化的供应和严格的资本部署来对冲下行风险，从而赢得竞争。达成此类平衡可有助企业领导者将今天的乐观情绪转化为持久的盈利增长。

[10]《Global Semiconductor Market Approaches $1T in 2026》，世界半导体贸易统计协会，2025年秋

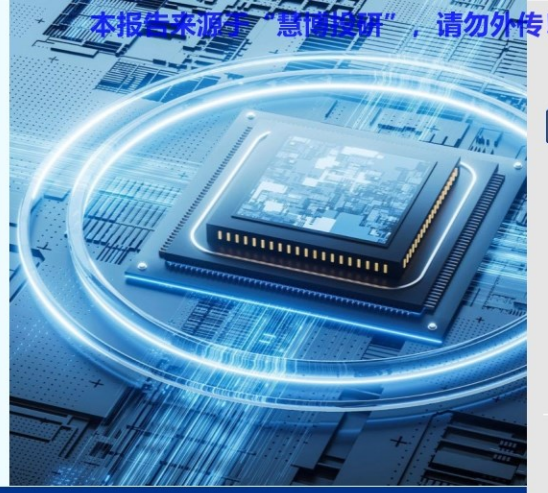
[11]《Is This the New Dot-Com Bubble? Semiconductors, Nasdaq, and the AI Productivity Cycle》，MacroMicro，2025年11月11日

© 2026 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！

主要建议

对于半导体企业而言，人工智能已不再是新兴机遇，而是该行业最重要的单一收入驱动因素。这种转变要求企业领导者围绕人工智能快速调整产品、运营和资本战略，并灵活适应区域动态发展。



1 抓住内存与微处理器需求并驾齐驱的增长良机

随着内存产品需求激增带来巨大的增长机遇，为新建和扩建的生产设施及超大规模数据中心提供所需的能源，已成为一项重大的战略挑战。企业领导者若能立刻采取行动调整产品、客户目标和能源战略，将可获得持续增长的优势地位。

加倍投入高带宽内存创新

重点投资高带宽内存研发和制造，确保产品在速度、效率和热性能方面均能满足人工智能工作要求。

与科技巨头建立战略合作伙伴关系

使产品开发周期与科技巨头（亚马逊、谷歌云、微软Azure）的路线图需求保持一致，并共同投资实施供应和集成战略以确保获得长期合同。

在传统内存之外寻求差异化

将营销和销售重点放在先进内存与动态随机内存相比的性能、优化和可持续性优势方面，将产品定位为人工智能关键设备。

直面能源供应风险

与公用事业和可再生能源供应商开展联合规划，以确保达成长期能源供应协议；可考虑在能源需求较高的地区建设或共同持有能源基础设施。

利用人工智能提升能效

在内部晶圆厂和外部客户解决方案中利用人工智能进行优化，以降低每个计算单元的能耗，从而改善可持续性，构建竞争优势，并降低供应风险。

© 2026 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!

2 增强供应链灵活性以应对地缘政治动荡

在地缘政治压力、关税、贸易限制以及能源或资源供应威胁到供应链灵活性的情况下，企业领导人必须采取战略以减少薄弱环节，提高响应能力并保持创新的战略。目前态势转变已十分明确，供应链灵活性不再是可选项，而是竞争力的先决条件。



分散供应源和供应地

致力分散供应链区域分布（目标是在三年内至少提高50%），以减少对中国台湾等单一地区的依赖，并降低供应中断风险。

推动供应链运营数字化和自动化

加快在采购和物流领域部署人工智能预测分析和自动化，以更早地识别风险，优化库存，并更快地应对市场和地缘政治冲击。

平衡国内与全球制造以确保供应韧性

虽然制造业向美国和欧洲回流或就近布局可以减少战略瓶颈，但也应确保开展互补性的全球采购，以避免供应过度集中，并保持有竞争力的成本结构。

预测关税影响并制定应对计划

鉴于73%的受访者将关税视为目前地缘政治的首要问题，应针对多种贸易情景建立模型，并制定灵活的定价和运营计划，以应对政策骤变。

与政府达成战略性合作

在寻求政府补贴或部分持有资产的同时，通过条款谈判确保市场灵活性和创新自由，并利用公共投资联合建设先进制造能力。

© 2026 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!

3 利用人工智能增强人才韧性和生产力

从IT和研发到供应链、营销和销售，生成式人工智能和代理式人工智能正推动半导体行业各种职能迅速转型，从而简化流程，优化决策并实现更快的创新周期。企业高管必须制定人才和技术兼顾的战略，才能在人工智能为先的时代占据竞争优势。



将人工智能纳入生产力提升战略

在IT、研发、采购和供应链等重要领域部署人工智能，以加速决策，增加设计产出，增强运营韧性。

借助人工智能留住人才

将人工智能融入日常工作流程，以消除重复性任务，使员工能专注于高价值的创造性工作，从而提高他们对工作的满意度并降低离职率。

着力提升员工的人工智能素养

开展持续培训计划，以帮助员工充分利用生成式人工智能和代理式人工智能，重点关注跨职能应用并确保符合相关道德准则。

使人工智能应用契合增长目标

确保人工智能部署符合业务扩展计划，在不增加运营复杂性的情况下通过灵活流程吸纳增加的员工。

利用人工智能优化客户服务

在营销和销售中利用代理式人工智能创造个性化互动，提高预测准确性，并缩短上市销售时间。

© 2026 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!

4 在经济和地缘政治不确定性中维持战略增长

当前半导体行业乐观情绪高涨，这从信心得分的上升和创纪录的资本支出计划中可见一斑，但也面临着客户需求波动和地缘政治风险的影响。企业领导者必须在积极寻求增长与严格管理风险之间取得平衡，以便在这个高增长周期中建立竞争优势，同时避免过度扩张。



根据人工智能和数据中心需求调整扩张计划

重点投资逻辑芯片和高带宽内存等高增长产品领域，确保新增产能可直接满足最具持续性的需求驱动因素。

调整增长策略以应对需求不确定性

对多种需求场景进行建模，并将员工人数、IT升级和并购活动与应变触发条件相关联，而非在不考虑市场条件的情况下坚守一成不变的增长目标。

尽早投资建设战略基础设施

由于多达66%的受访企业将增加资本支出，因此应在竞争对手锁定资源之前，确保获得先进制程晶圆产能、先进封装能力以及稀土和化学品供应协议。

通过并购加速技术获取和市场准入

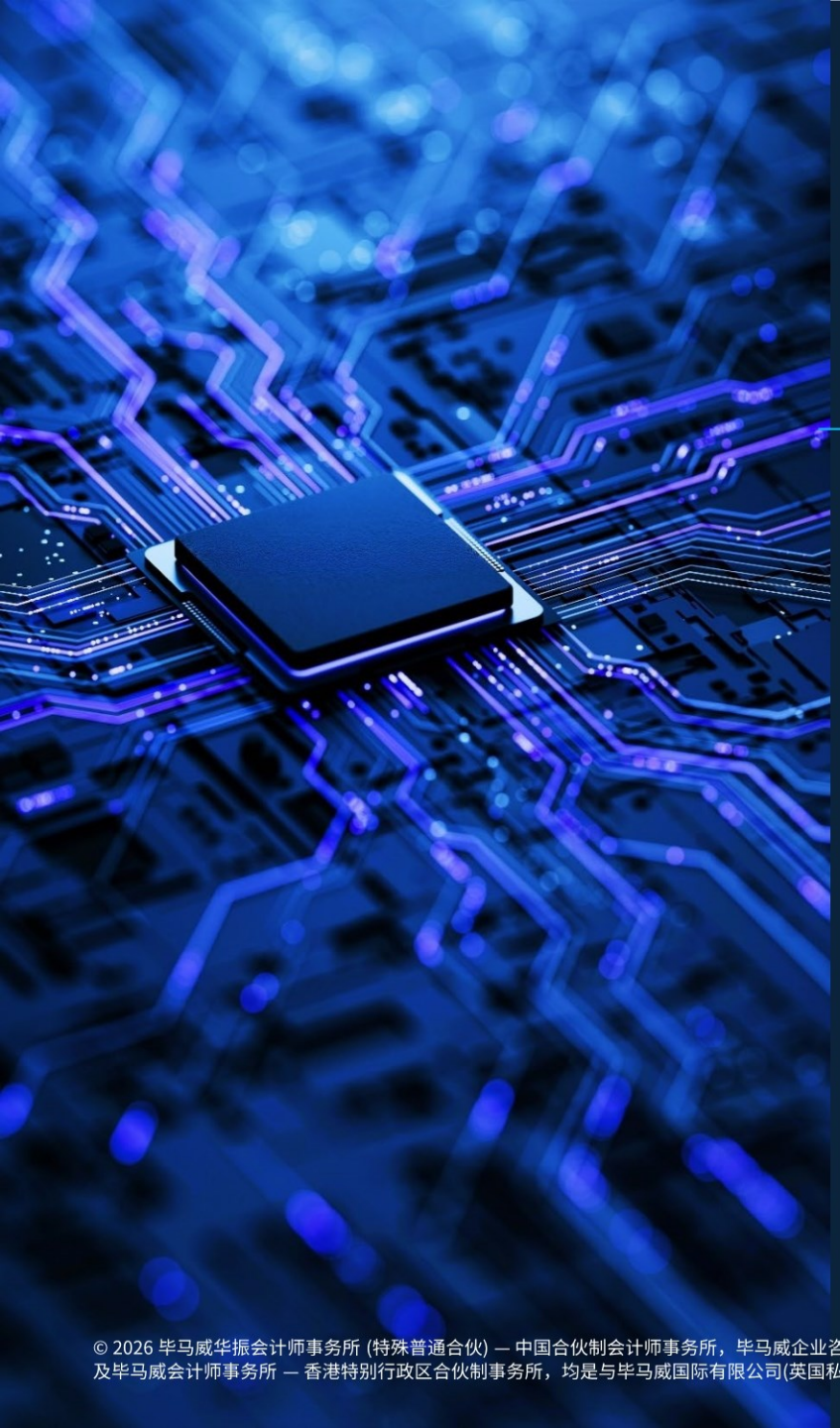
通过并购重点加强人工智能技术、区域制造分布和差异化能力，以增强供应链韧性。

保持财务灵活性以应对市场变化

保持流动性并严控利润率，利用储备为创新提供资金，同时确保在地缘政治或需求条件恶化时能够放缓或调整投资方向。

© 2026 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!



毕马威和全球半导体联盟可提供的专业服务

关于毕马威与全球半导体联盟

毕马威全球半导体业务

技术对个人和职业生活的影响无处不在。半导体行业正引领数字化的互联世界勇往直前。毕马威全球半导体业务的目标是协助半导体企业应对挑战、乘风破浪。毕马威在全球范围内与各种规模的半导体企业合作，应对眼下最紧迫的行业挑战，同时预测最佳战略选择，为客户企业带来短期和长期成功。如需更多信息，请访问：

www.kpmg.com/semiconductors

全球半导体联盟

GSA是各界领袖会商建立高效、盈利和可持续半导体生态系统与高科技全球生态系统的组织，囊括半导体产品、解决方案、系统和服务。作为一家全球领先的行业组织，GSA代表300多家企业会员，包括超过130家上市公司。GSA提供了一个独特、中立的合作论坛，使其会员能够与同行、合作伙伴和客户进行交流和合作，从而实现其目标，使投入资本和智力资本回报最大化。GSA的成员企业占比超过半导体行业，GSA的成员企业占比超过
请访问：

www.gsaglobal.org。

人在草木间
更多资料请加V

© 2026 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。

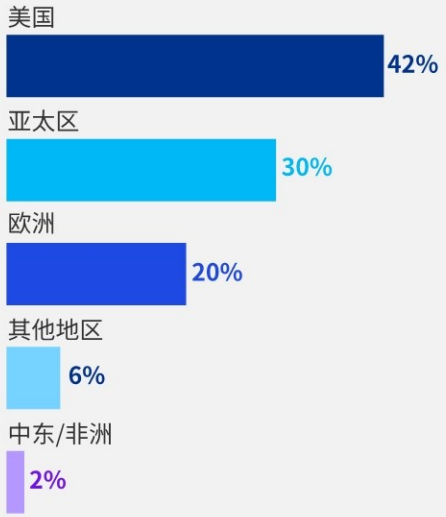
本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!

研究方法

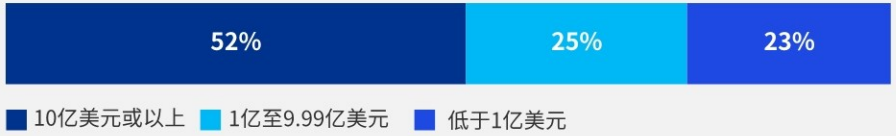
此次调查由毕马威与全球半导体联盟共同开展。相关数据通过2025年第4季度在线调查从151名受访者处收集。下图概述了受访者的大致情况。

2025年受访者人数 = 151

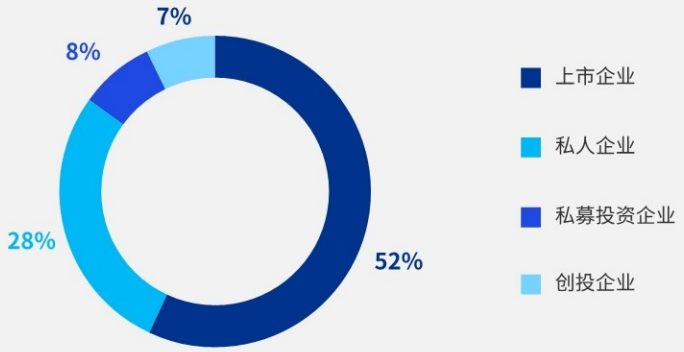
总部所在区域



企业年收入



企业类别



受访者职衔

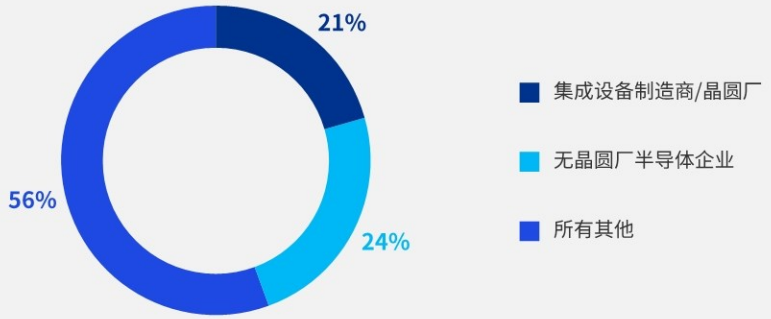


30%
首席级



70%
副总裁/董事/其他

行业分部



© 2026 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!

作者简介

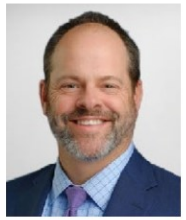


Christian Gentle

毕马威全球半导体业务主管合伙人
毕马威美国
电邮：christiangentle@kpmg.com

Chris Gentle是毕马威全球半导体业务的主管合伙人，也参与美国科技、媒体及电信业务。他在硅谷和伦敦办事处工作了31年，致力为半导体、软件和生命科学行业的公私企业提供审计和交易咨询服务，具有丰富的从业经验。

Chris曾以主管合伙人的身份为多家《财富》500强半导体和其他科技企业提供服务，在并购、业务剥离、数字化和人工智能转型以及监管合规方面拥有丰富的经验。



Chad Seiler

科技、媒体及电信业务主管合伙人
毕马威美国
电邮：cseiler@kpmg.com

Chad Seiler是毕马威美国科技、媒体及电信业务主管合伙人，致力帮助一些该行业的巨头应对业务挑战并实现持续价值。他具有28年毕马威工作经验，曾在硅谷、旧金山和圣安东尼奥的办公室工作。

作为科技、媒体及电信业务主管合伙人，Chad负责毕马威美国的数字转型、分析和人工智能、绩效优化、网络安全和隐私保护、风险和合规、ESG、监管变革以及未来工作模式等关键业务领域的市场拓展工作。其职责包括帮助制定科技、媒体及电信行业战略，培养高技能的跨职能团队，加强解决方案战略和推动创新。Chad也与业界资深专业人士、营销和销售团队以及联盟合作伙伴保持密切合作。



Cecil Mak

美国科技行业主管合伙人
毕马威美国
电邮：cecilmak@kpmg.com

Cecil Mak是毕马威科技行业主管合伙人，他致力利用自己27年的从业经验，帮助一些影响力深远的大型科技企业应对多变的商业环境，并利用人工智能和其他数字化转型能力把握发展机遇。他负责为毕马威审计、税务和咨询业务客户提供科技行业战略和执行等方面的服务。Cecil也是毕马威硅谷办事处的主管合伙人，以及该办事处的美国证券交易委员会审查合伙人之一。此前，他曾在美国证券交易委员会首席会计师办公室担任研究员，并在毕马威美国国家办事处担任合伙人。

鸣谢：

感谢Lisa Bigelow、Daniel Cohen、Hasan Dajani、Ken Fodor、Natalie Galindo、Alyssa Mora、Jessica Mueller、Robert Rosta、Lara Volpe、Alison Wentley和Kathy Wheeler对本报告撰写提供的支持。

© 2026 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!

近期领先思维刊物



毕马威2026全球技术报告



跨越奇点：世界模型如何重塑具身智能产业与商业新范式

本报告所载的某些或全部服务可能未获准提供予毕马威的审计客户及其附属公司或关联主体。

浏览下列网站
了解我们：

kpmg.com

Subscribe

所载资料仅供一般参考用，并非针对任何个人或团体的个别情况而提供。虽然本所已致力提供准确和及时的资料，但本所不能保证这些资料在阁下收取时或日后仍然准确。
任何人士不应在没有详细考虑相关的情况及获取适当的专业意见下依据所载资料行事。
© 2026 KPMG LLP是一家位于美国特拉华州的有限责任合伙制事务所，其子公司是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。
毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。DASD-2026-19652

© 2026 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!

联系我们



刘婧媛
Sophie Liu
毕马威中国北方区
半导体行业审计主管合伙人
+86 (10) 8508 7339
sophie.jy.liu@kpmg.com



李吉鸣
Jamie Li
毕马威中国
半导体行业主管合伙人
+86 (21) 2212 2558
jamie.li@kpmg.com



陈怡
Cathy Chen
毕马威中国华南区
半导体行业审计主管合伙人
+86 (20) 3813 7906
cathy.y.chen@kpmg.com

© 2026 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！

kpmg.com/cn/socialmedia





如需获取毕马威中国各办公室信息，请扫描二维码或登陆我们的网站：https://kpmg.com/cn/zh/about/office-locations.html

本刊物经毕马威国际授权翻译，已获得原作者授权。本刊物为毕马威国际发布的英文原文“Global Semiconductor Industry Outlook 2026”的中文译本。如本中文译本的字词含义与其原文刊物不一致，应以原文刊物为准。

所载资料仅供一般参考用，并非针对任何个人或团体的个别情况而提供。虽然本所已致力提供准确和及时的资料，但本所不能保证这些资料在阁下收取时或日后仍然准确。任何人士不应在没有详细考虑相关的情况及获取适当的专业意见下依据本刊物所载资料行事。

© 2026 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。

毕马威的名称和标识均为毕马威全球组织中的独立成员所经许可后使用的商标。

在本文中，“我们”、“毕马威”和“我们的”指全球性组织毕马威国际有限公司(“毕马威国际”)或其一家或多家成员所。毕马威国际及各成员所均为各自独立的法律实体。

本刊物中包含的外部观点和意见均为受访者的观点和意见，并不一定代表毕马威国际或任何毕马威成员所的观点和意见。毕马威就此发表的观点和意见不代表对任何公司产品或服务的认可、支持或背书。

由 Evalueserve 设计。

刊物名称：2026年全球半导体行业展望

刊物编号：1776742674359

出版日期：2026年10月